



(一社) スマートプロセス学会シンポジウム賞
Mate2025 奨励賞

大阪大学大学院 内田 弘翔 殿

受賞論文名

「Ag-Cu 合金の脱合金化による表面 Ag ナノポーラス
シートの作製と接合性評価」

接合科学研究所・JWR

あなたが「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術
シンポジウム Mate2025」において発表された首記の研究は
学術的にはもちろんのこと工学的見地からも優れており 将来
にわたり貴殿の研究の発展を期待するのに相応しい内容と
判断されましたのでその業績を讃えるとともに 今後のます
ますのご活躍を期待しここに表彰します

2025年1月29日

一般社団法人スマートプロセス学会

会長 田中 学